

電源分配ボックス（PDB）

量産品

2025年搭載予定

従来のジャンクションブロック(J/B)に対し、半導体リレーによる電源分配機能の高集積化と付加価値機能を追加

背景・課題

電源分配ボックスの搭載スペースが少なくなっており、小型化・高集積化が求められている

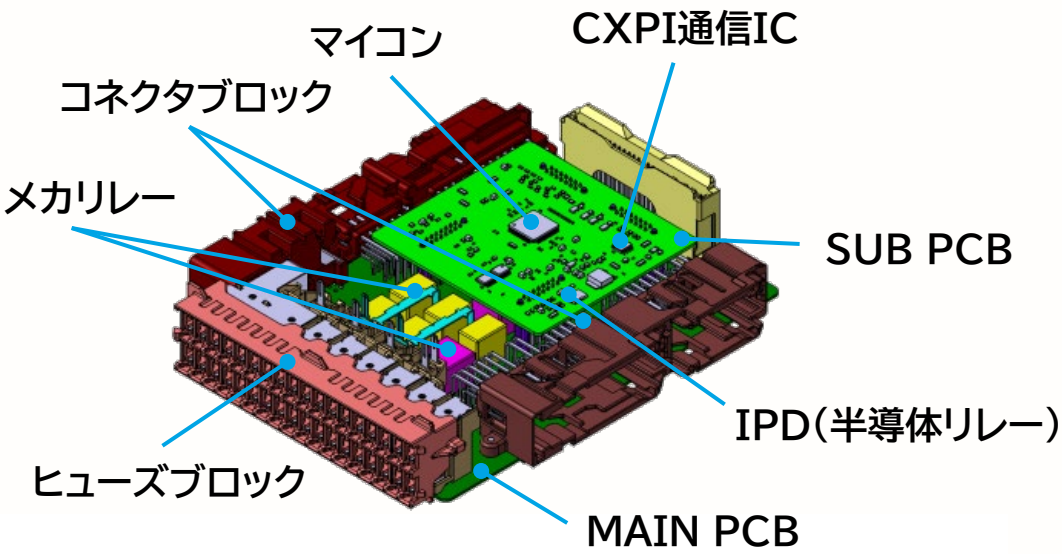
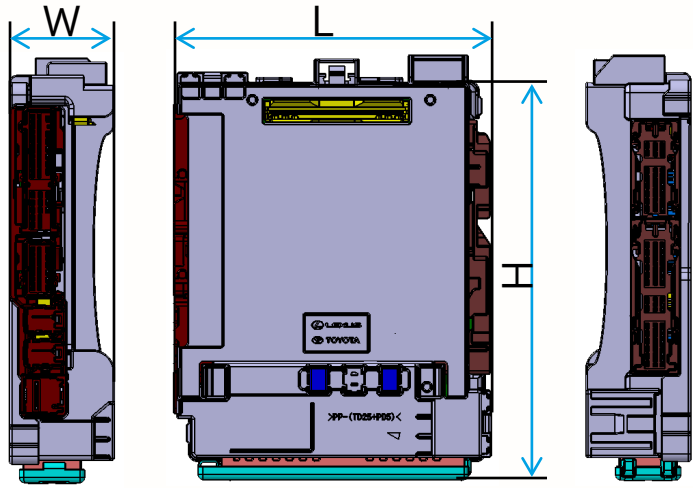
課題への解決・特徴

- 1 半導体リレーの採用による小型、高集積化
- 2 半導体ヒューズの採用によるメンテナンスフリー化
- 3 マイコンの活用による自己診断/故障検知機能

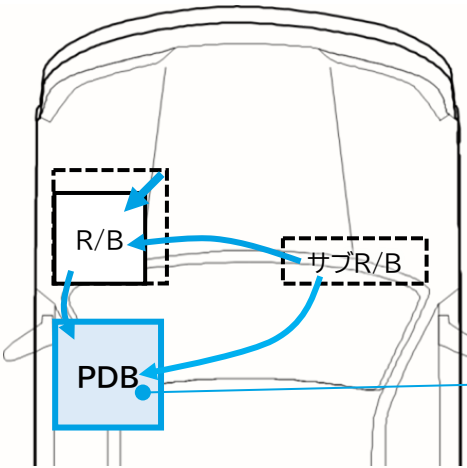
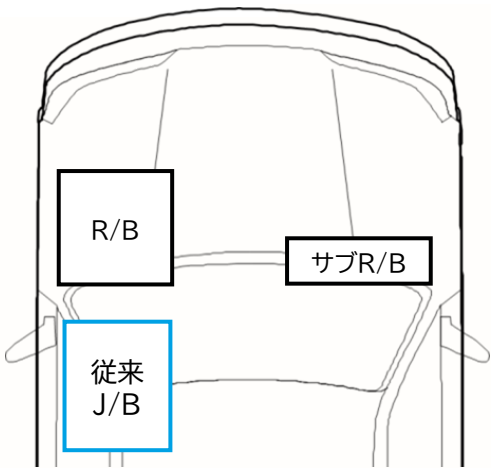
主要性能、仕様・構造

ヒューズ	46個
メカリレー	11個
半導体リレー	7個
コネクタ端子数	157本

総通電電流値	約120A
体格(L×W×H)	142×47×180[mm]
通信プロトコル	CXPI



PDB適用時の効果



- ・サブR/B廃止
- ・R/Bの体格縮小可能
- ・リレー/ヒューズ追加可能



※R/B:リレーボックス